

证券代码：002134

证券简称：天津普林

公告编号：2024-032

天津普林电路股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

被担保人名称：泰和电路科技（惠州）有限公司（以下简称“惠州泰和”）为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

本次担保金额及已实际提供的担保余额：本次公司拟为惠州泰和提供的担保额为4,590万元，前述担保额度目前尚未实际发生，担保协议尚未签署。

公司及控股子公司拟对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足经营及业务拓展的资金需求，公司控股子公司惠州泰和拟继续向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请4,000万元综合授信额度，向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请不超过5,000万元综合授信额度。公司及惠州泰和另一股东惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘瑞成”）按持有惠州泰和的股权比例提供连带责任保证担保。公司本次拟提供的担保额度不超过4,590万元。具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保不存在反担保。

公司于2024年5月7日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司惠州泰和申请银行授信提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：泰和电路科技（惠州）有限公司

成立日期：2009年12月17日

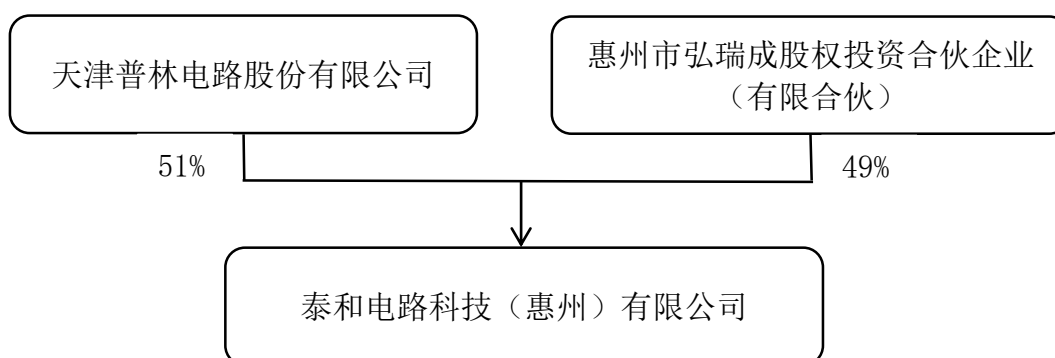
注册地址：惠州市仲恺高新技术开发区平南工业区48号小区

法定代表人：易剑平

注册资本：14,693.8776万元人民币

经营范围：高精密单面、多层电路板、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板、表面贴装加工、电子零配件、电子耗材、电子产品、机器零配件、五金零配件的研发、制造、加工及销售，货物及技术进出口，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：



惠州泰和为公司合并报表范围内的控股子公司，其主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月
资产总额	60,120.03	65,530.84
负债总额	23,382.29	25,725.08
净资产	36,737.74	39,805.75
营业收入	41,409.91	11,259.70
利润总额	4,166.14	1,039.13
净利润	3,447.37	868.01

经查询，惠州泰和不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保为拟担保授权事项，尚未签署相关担保协议，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与交易对方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保是为了满足控股子公司生产经营、业务发展的资金需要，有利于其稳健经营和长远发展，惠州泰和另一股东惠州市弘瑞成股权投资合伙企业（有限合伙）提供同比例担保，不存在损害公司利益的情况。董事会同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司实际发生对外担保金额为 750.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.66%。

上述担保全部为公司及控股子公司对合并报表范围内公司提供的担保。公司无逾期担保情况。

六、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月八日